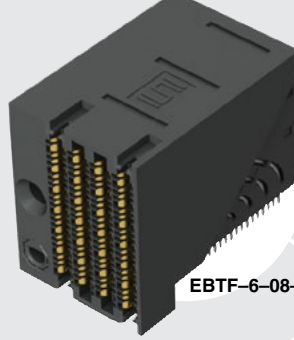


ExaMAX[®]



EBTF-6-08-2.0-S-RA-1-L-A



EBTF-4-08-2.0-S-RA-1

(2.00 mm) .0787"

ExaMAX[®] BACKPLANE SYSTEM

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?EBTF-RA

Insulator Material: Liquid Crystal Polymer
Contact Material: Copper Alloy

Plating:

Sn or Au over
 50 μ" (1.27 μm) Ni

Operating Temp Range:
 -55 °C to +105 °C

Current Rating:
 4.2 A per pin
 (1 pin powered)

Contact Wipe:
 2.4 mm

RoHS Compliant:
 Yes

Mates with:
 EBTM, EBDM

2.00 mm
 column pitch

PAM 4

56
 G b p s

Press-fit
 termination

Two reliable
 points of contact
 with 2.4 mm wipe

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



EBTF

NO. OF PAIRS
 PER COLUMN

COLUMNS

COLUMN
 PITCH

-4 = 4 Pairs

-6 = 6 Pairs

-06

-08

-10

-12

(-6 only)

-2.0

= (2.0 mm)

.0787"

ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

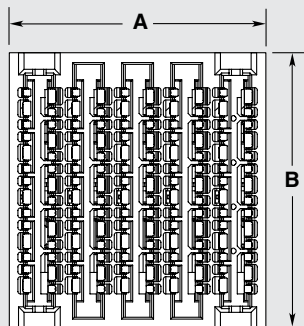
- Staging

TOOLING

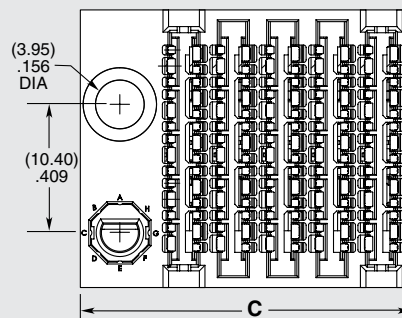
- For press-fit extraction and insertion tool options, visit www.samtec.com/tooling

NO. OF PAIRS PER COLUMN	B
-4	(22.50) .886
-6	(29.70) 1.169

COLUMNS	A	C
-06	(12.90) .508	(18.85) .742
-08	(16.90) .665	(22.85) .900
-10	(20.90) .823	(26.85) 1.057
-12	(24.90) .980	(30.85) 1.215



NO GUIDANCE SHOWN



WITH GUIDANCE SHOWN

Notes:

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

ExaMAX[®] is a registered trademark of AFCL.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



EBTF-6-6-2.0-S-RA-1-L



EBTF-6-12-2.0-S-RA-1



EBTF-4-10-2.0-S-RA-1

EBTF-RA SERIES



PLATING

RA

1

GUIDANCE

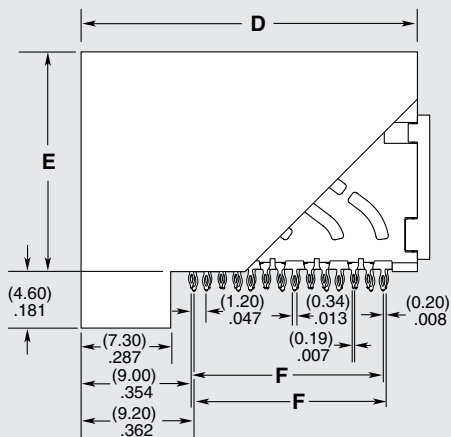
KEYING

-S
= 30 μm (0.76 μm) Gold on contact area,
Matte Tin on tail

(Leave Blank for no Guidance)
-L
= Left Guidance
-R
= Right Guidance

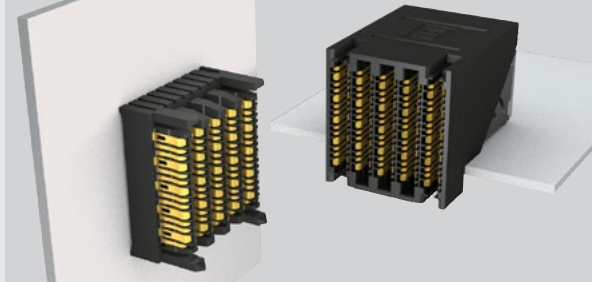
(Only available with -L or -R guidance)
(Leave Blank for no keying)
-A thru -H
= Position of flat on Key
(See table for Key)

GUIDANCE	KEYING							
	-A	-B	-C	-D	-E	-F	-G	-H
-R /-L								



EBTF-4-10-2.0-S-RA-1-L-A SHOWN

APPLICATION



NO. OF PAIRS PER COLUMN	D	E	F
-4	(28.40) 1.118	(17.90) .705	(15.60) .614
-6	(35.60) 1.402	(25.10) .988	(22.80) .898

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9